

# TRIPOD100/100T TRIPOD100激光直接成像设备



完美的激光直接成像解决方案



HIGH PERFORMANCE,  
MASKLESS LITHOGRAPHY SYSTEM

芯基微装Tripod系列LDI是一款高性能、全能型激光直接成像系统，采用大功率曝光光源设计可适用所有UV、干膜、湿膜等感光材料直接成像，并结合高精度的成像和定位系统可实现 $30\mu\text{m}/30\mu\text{m}$ 的解析，其可兼容外层线路、防焊等制程需求，为不同的PCB、柔性板提供了完美的解决方案。

# TRIPOD100/100T TRIPOD100激光直接成像设备

HIGH PERFORMANCE,  
MASKLESS LITHOGRAPHY SYSTEM



## 产品优势

### 全能型

内、外、防焊一体

### 高精度

30/30 $\mu$ m解析, 最小开窗50 $\mu$ m

### 高产能

单台产量高达1700片/天  
双台面联机6000片/天

### 大台面

最大曝光面积24"\*26"  
适用客户多种尺寸

### 智能涨缩

自动侦测、自动归类、  
指定倍率曝光

### PE、JE管控

Judgement Error对位孔偏移判  
断, Process Error涨缩偏移判断

### 三点拟合对位

采用三点把残缺靶标  
拟合真圆进行对位

### 三/四靶标对位

可再用三/四靶标对位

### 高智能

无底片作业、缩短流程、  
解决涨缩不良缺陷、减  
少因底片工具所产生的缺陷

### 分区域对位

自动单独区域计算涨缩曝光、  
自定义分区对位、最大可支  
持100各分区

### 二维码设计、信息制定

任意指定位置、输入任意信息、  
方便查询、降低客诉成本

## 技术参数

芯碁LDI机型指标	
型号	Tripod100
适用制程	内层/外层/防焊
最大曝光面积	24"*26"
曝光方式	DMD+LD
基板厚度	0.05mm-5mm
最小线宽线距	35 $\mu$ m/35 $\mu$ m
线宽均匀性	$\pm$ 10%
对位精度	$\pm$ 12 $\mu$ m
层间对位精度	24 $\mu$ m
光源寿命	8000hrs
对位视场范围	12mm*9mm
支持格式	Gerber274D/X;ODB++
波长	405nm
生产效率 (18"*24")	10mJ/cm <sup>2</sup> 155面/hr
	60mJ/cm <sup>2</sup> 100面/hr
	110mJ/cm <sup>2</sup> (湿膜) 70面/hr
	200mJ/cm <sup>2</sup> (防焊) 45面/hr
机台尺寸	长: 280cm宽: 175cm高: 170cm
机台重量	2800kg
工作环境	电源:380V $\pm$ 5%,50/60Hz,5KW
	设定温度:18-24 $^{\circ}$ C,变化范围 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C
	设定湿度:40-60%,变化范围 $\pm$ 5%
	洁净度:1000级



## 样片

